

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム (SenTePack)

第2回総会・第4回研究会 プログラム

1、開催日時：2026年2月20日(金) 13:00~16:55

2、開催方式：会場/Online（ハイブリッド開催）

3、開催会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館11階 第1会議室

4、会場アクセス：<https://www.aist.go.jp/waterfront/ja/access/index.html>

5、プログラム：

13:00~13:30 総会

13:30~13:40 研究会開会挨拶 SenTePack 会長 植村 聖

13:40~14:20 WG活動報告

- ・センシング材料WG

- ・環境モニタリング技術WG

- ・人・機械インタラクションWG

- ・半導体製造センシング・実装技術WG

14:20~15:20

講演1「製造DXの現在地と次の一手」

株式会社SparkPlus CEO 本田 純平 様

15:20~15:50 コーヒーブレイク（名刺交換・意見交換）

15:50~16:50

講演2「半導体3D集積とチップレットの研究開発動向（仮題）」

横浜国立大学 准教授 井上 史大 様

16:50~16:55 研究会閉会挨拶 SenTePack 副会長 吉田 学

お問い合わせ先：

SenTePack事務局

国立研究開発法人産業技術総合研究所センシング技術研究部門

e-mail : M-SenTePack-ml@aist.go.jp